ON Semiconductor®

Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN22814Z
Issue Date:26 Feb 2020

Title of Change:	Test platform conversion from TMT to uFlex.
Proposed Changed Material First Ship Date:	26 Feb 2021 or earlier if approved by customer.
Current Material Last Order Date:	N/A *Orders received after the Current Material Last Order Date expiration are to be considered as orders for new changed material as described in this PCN. Orders for current (unchanged) material after this date will be per mutual agreement and current material inventory availability*.
Current Material Last Delivery Date:	N/A *The Current Material Last Delivery Date may be subject to change based on build and depletion of the current (unchanged) material inventory*
Product Category:	Active components – Integrated circuits
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Patrick.VandePontseele@onsemi.com>
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office to place sample order or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 45 days after publication of this change notification. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Sample Availability Date:	N/A
PPAP Availability Date:	N/A
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Dimitri.Tack@onsemi.com>
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 12 months prior to implementation of the change or earlier upon customer approval. ON Semiconductor will consider this proposed change and it's conditions acceptable, unless an inquiry is made in writing within 45 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com.

Change Category

Category	**Type of Change**
Equipment	Production from a new equipment/tool which uses the same basic technology (replacement equipment or extension of existing equipment pool) without change of process.

Description and Purpose:

The change is a test program conversion from the TMT test platform to the uFlex test platform.

There are no product material changes as a result of this change.

There is no product marking change as a result of this change.

Reason / Motivation for Change:	Source/Supply/Capacity Changes Process/Materials Change
Anticipated impact on fit, form, function, reliability, product safety or manufacturability:	The device has been qualified and validated based on the same Product Specification. The device has successfully passed the qualification tests. Potential impacts can be identified, but due to testing performed by ON Semiconductor in relation to the PCN, associated risks are verified and excluded. No anticipated impacts.

ON Semiconductor®

Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN22814Z
Issue Date:26 Feb 2020

Sites Affected:	
ON Semiconductor Sites	**External Foundry/Subcon Sites**
ON Semiconductor Carmona, Philippines	None

Marking of Parts/ Traceability of Change:	NA

Reliability Data Summary:

Reliability data is not impacted.

Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Part:

Note: *Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the* ***PCN Customized Portal****.*

Current Part Number	New Part Number	Qualification Vehicle
NCV7342D10R2G	NA	NCV7342D10R2G

Japanese translation of the notification starts here.

通知の日本語訳はここから始まります。

Note*: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます.

ON Semiconductor®

最終製品 / プロセス変更通知

文書番号#：FPCN22814Z
発行日:26 Feb 2020

変更件名:	TMT から uFlex へのテストプラットフォーム変更.
初回出荷予定日:	26 Feb 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前
現在の材料の最終注文日:	N/A 既存品の最終注文日以降の注文は、この PCN に記載されている変更後品の注文とみなされます。この日付より後の既存品(変更前品) の注文は、相互契約により変更前品の在庫状況に応じて履行されます。
現在の材料の最終出荷日:	N/A 既存品 (変更前品) の最終出荷日は、変更前品の製造および在庫の状況によって変更されることがあります。
製品カテゴリ:	アクティブなコンポーネント–集積回路
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または<Patrick.VandePontseele@onsemi.com>にお問い合わせください。
サンプル:	サンプルの注文または<PCN.samples@onsemi.com>を注文するには、お近くの ON Semiconductor 営業所にお問い合わせください。 サンプルのリクエストは、この変更通知の公開後 45 日以内に提出してください。 サンプルの納品時期は、リクエスト日、サンプル数量、特別なお客様の梱包/ラベルの要件に従います。
サンプル提供開始可能日:	N/A
PPAP 提供開始日:	N/A
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または<Dimitri.Tack@onsemi.com>にお問い合わせください。
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。 FPCN は、変更実施の 12 か月前、またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前に発行されることがあります。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 45 日以内に書面による問い合わせが行われない限り、この変更希望およびその条件が受諾されたものとみなします。 お問い合わせは、PCN.Support@onsemi.com にお願いします。
変更カテゴリ:	**変更種別**
装置	プロセス変更をともなわない同じ基本技術を使用した新しい機器/機材(機器の交換または既存機器プールの拡張) での生産。

説明および目的:

変更は、TMT テストプラットフォームから uFlex テストプラットフォームへのテストプログラムの変換です。

この変更の結果としての製品材料の変更はありません。

今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。

変更の理由 / 動機:	ソース/供給/新規ウェハー径/材料の変更
適合性、形状、機能、信頼性、製品安全性、または製造可能性に関して見込まれる影響	製品は同じ製品仕様に基づいて認定および検証されています。製品は認定試験に正常に合格しています。潜在的な影響が確認される可能性がありますが、オン・セミコンダクターが PCN に関して実施する検査により、関連するリスクは検証および排除されます。 予想される影響はありません。

ON Semiconductor®

最終製品 / プロセス変更通知

文書番号#：FPCN22814Z
発行日:26 Feb 2020

影響を受ける拠点:	
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:
ON Semiconductor Carmona, Philippines	無し
部品の表示 / 変更の追跡可能性:	N/A

信頼性データの要約:

信頼性データは影響を受けません。

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 標準の部品番号(既製品)のみが部品一覧に記載されます。 本 PCN に影響を受けるカスタム 部品は、PCN メールの顧客の特定の PCN の付属文書、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

現在の部品番号	新部品番号	認定試験用ピークル
NCV7342D10R2G	NA	NCV7342D10R2G

Appendix A: Changed Products

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
NCV7342D10R2G	0CANV-001-XTP	NCV7342D10R2G	NA	